

國立中興大學微奈米金屬化製程技術聯盟合約書

立約人 _____（以下簡稱甲方）與國立中興大學（以下簡稱乙方），茲因乙方依據「行政院國家科學委員會補助產學技術聯盟合作計畫試行要點」，以乙方已建立之核心技術，與相關之上中下游產業界建構微奈米金屬化製程技術聯盟（以下簡稱本聯盟），就甲方加入乙方本聯盟，雙方特訂立本合約，並同意條款如下：

第一條：聯盟與會員

- 一、甲方同意加入乙方設立之本聯盟，乙方同意接受甲方加入本聯盟為會員。
- 二、甲方同意遵循本聯盟、乙方及行政院國家科學委員會（以下簡稱國科會）之相關法規。

第二條：會員資格

甲方於本約依法簽訂後即取得本聯盟會員資格。甲方會員資格於簽約日起一年內有效，期滿時甲方如續繳年費則視同續約。

第三條：聯盟年費

甲方同意給付乙方聯盟年費每年新台幣_____萬元整，並於簽約後一個月內支付。乙方應於甲方支付聯盟年費之同時檢具收據予甲方，年費一經給付，縱因合約終止或解除亦不退還。

第四條：費用動支

乙方應將本聯盟之年費收入單獨設帳，甲方同意本聯盟之會員年費收入得依本聯盟成立宗旨及乙方各支用辦法及相關法規動支，包含人事費、耗材費、國內外差旅、國內外舉辦之研討會報名費或註冊費、國內或國際性學會之年費或入會費、因研究需要邀請執行機構外人員之專家諮詢費及出席費、會議餐費、計劃相關之教育訓練費、研究計畫所需的圖書費、印刷與影印費、文具紙張費、郵電費、儀器維護費及雜項費用等與本聯盟運作相關之支出。

第五條：本聯盟服務項目

- 一、金屬化前處理濕製程技術。
- 二、印刷電路板金屬化技術。
- 三、晶片封裝基板金屬化技術。

- 四、2.5D & 3D 晶片堆疊封裝金屬化技術。
- 五、LED 3D 封裝金屬化技術。
- 六、智慧型手機天線金屬化技術。
- 七、軟性印刷電路板金屬化技術。

第六條：會員權利

甲方在其會員資格有效期間得參與本聯盟下列合作項目：

- 一、技術授權（授權條件另議，須另行簽約）。
- 二、產學合作研究計畫（須另行簽約）。
- 三、配合會員需求提供技術文件摘要等。
- 四、技術服務。
- 五、專業諮詢服務。
- 六、配合會員需求提供訪廠現地指導。
- 七、提供訓練課程，推廣教育、本聯盟舉辦之學術研討會等服務（會員享有兩位免費名額）。
- 八、提供化工系電化學暨電子特用化學實驗室，協助進行實驗。
- 九、提供本聯盟規畫之場地租借舉辦會議。
- 十、定期提供相關期刊最新資訊。
- 十一、儀器檢測服務（另行收費）。

第七條：保密義務

- 一、甲乙雙方因參與第六條所述之合作項目而知悉或持有與合作項目相關之機密文件或資訊時，對於前述文件或資訊具有保密之義務。
- 二、甲乙雙方應確認參與本聯盟之相關研究人員知悉本合約之保密義務。

第八條：智財權歸屬及成果發表

- 一、因本合約衍生之合作項目所獲得之研發成果（以下簡稱本成果），除經國科會認定歸屬該會所有者或另有契約約定外，全部歸屬乙方所有。
- 二、甲方運用或推廣本成果時，在未獲得國科會及乙方書面同意前，不得在利用本成果時（包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），引用國科會及乙方之名稱、會徽、校徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示國科會與乙方及其他聯盟會員有任何關連。甲方若違反前開規定，乙方將請求損害賠償。

三、因本成果而產製之專利產品，應明確標示專利證書號數。

四、乙方得將其在本聯盟各項合作項目中產生之研究成果公開發表之，但若有牽涉到甲方之機密資訊者應於事前得到甲方之同意。甲方無正當理由時，不得拒絕之。

第九條：合約修改

本合約之修改或增刪，非經雙方以書面方式訂定，不生效力。

第十條：合約終止

一、雙方於本合約有效期間內，得經書面同意終止本合約。

二、除本合約另有約定外，任何一方如違反或未履行本合約任一條款時，他方得以書面通知違反或未履行合約之一方於三十天內改善，逾期未改善者，本合約立即終止。

第十一條：合約有效期間

本合約有效期間為簽約日起一年（即__年__月__日至__年__月__日），雙方若無異議得依第三條規定展延，不限展延次數。惟年費調整時，應依調整後之年費為準。

第十二條：管轄法院

關於本合約或因本合約而引起之糾紛，甲乙雙方同意以誠信原則解決，如有訴訟之必要時，甲乙雙方同意以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。

第十三條：合約份數

本合約壹式參份，由甲乙雙方及聯盟負責人各執壹份為憑。

立約人

甲方： (印信)

代表人： (簽章)

職稱：

地址：

聯絡電話：

統一編號：

乙方：國立中興大學 (印信)
代表人：校長李德財 (簽章)
聯盟負責人：竇維平 (簽章)
任職系所及職稱：化學工程學系 教授
聯絡電話：04-22840510 #901
地址：臺中市南區國光路250號

中 華 民 國 年 月 日